2　階層は複数のサブ階層（一個のＯＦＤＭセグメントを三個に分割した単位で構成するものをいう。以下この条において同じ。）に分割して構成することができ、それぞれのサブ階層ごとに分割された伝送主信号について、前項に規定するキャリア変調マッピングを行って伝送主シンボルを生成した後に、複数のサブ階層を合成することで一個の階層を構成することとする。

3　データセグメントの送出手順は、別表第二十号の八に示すとおりとし、キャリア変調マッピング、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

4　サブ階層の構成手順は、別表第二十号の九に示すとおりとする。

（ＴＭＣＣシンボル等）

第二十三条の十一　ＴＭＣＣシンボルは、ＴＭＣＣ信号について、二相位相変調又は四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、位相回転及び周波数インターリーブによりＴＭＣＣセグメントを構成するものとする。

2　ＴＭＣＣセグメントの送出手順は、別表第二十号の十に示すとおりとし、周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

（ＳＰシンボル、ＣＰシンボル、ＢＰシンボル及びＬ　ｃｈシンボル）

第二十三条の十二　ＳＰシンボル、ＣＰシンボル及びＢＰシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したＳＰ信号、ＣＰ信号及びＢＰ信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第二十号の十一に示すとおりとする。

2　Ｌ　ｃｈシンボルは、Ｌ　ｃｈ信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第二十号の十二に示すとおりとする。

（伝送主信号）

第二十三条の十三　伝送主信号は、主信号（ＴＬＶパケットをいう。以下この条において同じ。）及び主信号の先頭を指示する情報（別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「ＦＥＣブロックヘッダ」という。）に、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正符号化した信号（次章、別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「ＦＥＣブロック」という。）を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第二十号の十三に示すとおりとする。

2　伝送主信号の誤り訂正は、別表第二十号の十四に示すＢＣＨ符号及びＬＤＰＣ符号を組み合わせた方式とする。

（ＴＭＣＣ信号）

第二十三条の十四　ＴＭＣＣ信号は、ＴＭＣＣ情報をパディング（ＴＭＣＣ情報及び誤り訂正外符号の情報ビット長が誤り訂正内符号の情報ビット長の整数倍になるように調整することをいう。）し、電力拡散信号を加算した信号に対して、誤り訂正外符号化、誤り訂正内符号化及び反復符号化した信号であり、その送出手順は別表第二十号の十五に示すとおりとする。

2　ＴＭＣＣ信号の誤り訂正は、別表第二十号の十六に示すＢＣＨ符号及びＬＤＰＣ符号を組み合わせた方式とする。

3　ＴＭＣＣ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。